



注：① 利用钢板基础内上下两层共4根 $10 \leq \phi < 16$ 筋板依据图示，相互通长连接成闭合回路作为接地体。
注：② 以 $-40 \times 4$ 熟铸纯铝扁钢作接地导体，下端与基础接地网可靠连接，然后引上至总等电位联结端子箱，并与其相连；接地导体不应少于2根，且应从接地网2处不同的地方引来；然后利用BV-1.5mm <sup>2</sup> -SC40将一体化设备内LEB与MEB以最短距离连接；MEB做法见J50502-P28~34页。
注：③ 距室外地坪0.5m处做接地电阻测试点，做法见J50503-P29。
注：④ 因实测接地电阻不满足要求而增设人工接地，并利用建筑物基础作为接地装置时，埋入土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料。